

Lead free wave soldering machine: GMS300

Especificaciones técnicas:

Método de control del sistema	Panel
Ancho del transportador	Máx.300 mm
Dirección del transportador de PCB	De izquierda a derecha / de derecha a izquierda
Tamaño de PCB	50-300mm
Ángulo de soldadura de PCB	4-7 °
Altura de alimentación de PCB	750 ± 50 mm
Temperatura del área de precalentamiento	Temperatura ambiente ~ 200 ° ajustable
Longitud de área de precalentamiento	1200 mm
Cantidad de áreas de precalentamiento	3 secciones
Modo de cambio de flujo de boquilla	Ajuste de presión de aire
Capacidad de la olla de soldadura	250 kg
Temperatura del recipiente de soldadura	Máx. temperatura ambiente ~ 350 ° C
Motor de onda	Frecuencia variable regulación de velocidad continua
Fuente de alimentación	3 Ph 380V 50HZ
Potencia total	Aprox. 19KW
Dimensión	3100 (L) * 1480 (W) * 1780 (H) mm (sin riel de guía)
Modo de pulverización de flujo	Cilindro
Peso	Aprox.1300kg
Volumen de flujo de flux	10-100ml / min.
Embalaje	Exención de caja de madera y envasado al vacío